

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年1月10日(2008.1.10)

【公開番号】特開2001-203222(P2001-203222A)

【公開日】平成13年7月27日(2001.7.27)

【出願番号】特願2000-379426(P2000-379426)

【国際特許分類】

H 01 L 21/52 (2006.01)

H 01 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/52 F

H 01 L 21/60 301K

【手続補正書】

【提出日】平成19年11月20日(2007.11.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】処理ステーションで湾曲した回路基板(3)を水平に引きよせるとともに押しつける吸引装置を備えたダイボンダあるいはワイヤボンダにおいて、前記吸引装置は、

- 前記回路基板(3)に対して支持面(2)を有し、該支持面(2)の方に向いて開口すると共に可撓性材料から構成された真空グリッパ(8.1;8.2;8.3;8.4)を位置決めしている少なくとも一つのキャビティ(7)を備えるプレート(1)と、

- 前記回路基板(3)に吸引力をかけるために前記支持面(2)のレベルよりも上側に前記真空グリッパ(8.1;8.2;8.3;8.4)を上昇させるとともに、前記回路基板(3)の搬送中は前記キャビティ(7)内に前記真空グリッパ(8.1;8.2;8.3;8.4)を下降させる手段と、

- 前記真空グリッパ(8.1;8.2;8.3;8.4)と真空源との間に配置され、前記回路基板(3)の搬送中に閉じて前記真空グリッパ(8.1;8.2;8.3;8.4)に真空をかけないバルブ(12;13)と、

を備えることを特徴とするダイボンダあるいはワイヤボンダ。

【請求項2】前記真空グリッパ(8.1;8.2;8.3;8.4)は、ベロー型の真空グリッパであることを特徴とする請求項1に記載のダイボンダあるいはワイヤボンダ。

【請求項3】前記吸引装置は、前記処理ステーションで前記回路基板(3)の下面に生じる真空を計測するためのセンサをさらに備えていることを特徴とする請求項1または2に記載のダイボンダあるいはワイヤボンダ。

【請求項4】前記支持面(2)は、前記処理ステーションの所定の位置に設けられたグループ(6)と、前記グループ(6)に真空をかけるための穴(5)とを備え、

前記回路基板(3)の搬送方向から見たときに、複数の前記キャビティ(7)の少なくとも1つが、前記グループ(6)の第1の側に設けられ、

複数の前記キャビティ(7)の少なくとも1つが、前記グループ(6)の反対側に設けられていることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載のダイボンダあるいはワイヤボンダ。